

การเสื่อมสภาพของระบบฟิล์มที่ให้การปิดป้องรังสีต่ำโดยมีชั้นเงินเป็นชั้นหลักมีสาเหตุสำคัญมาจากการซึมซึ่งแทรกซึมผ่านชั้นฟิล์มเคลือบทำให้เกิดการจับตัวเป็นก้อนของชั้นฟิล์มเงิน การคันหาชั้นป้องกันซึ่งมีความแข็งสูงเพื่อป้องกันการขีดข่วนบนผิวฟิล์มและผิวฟิล์มที่แน่นช่วยป้องกันการเกิดปฏิกิริยาเคมีซึ่งทำให้ฟิล์มเงินมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน ในการวิจัยนี้เลือกศึกษาฟิล์มชิลิกอนในไตรค์ซึ่งเคลือบโดยวิธี ดีซี พัลส์ แมกนีตอรอนสปีดเตอร์ริง การศึกษาจะมีการเปลี่ยนตัวแปรในการเคลือบต่างๆ คือกำลังไฟฟ้า ความกว้างพัลส์ไฟฟ้า ความถี่พัลส์ไฟฟ้า ความหนาฟิล์ม และอัตราการป้องก้าาร์กอนและในไตรเจนในระหว่างกระบวนการเคลือบเพื่อที่จะได้ฟิล์มป้องกันของชิลิกอนในไตรค์ที่มีสัดส่วนระหว่างชิลิกอนและในไตรเจนที่เหมาะสม ก้าวในไตรเจนที่ป้องต้องมีค่าสูงกว่าค่าวิกฤต ถ้าอัตราการป้องก้าวในไตรเจนต่ำกว่าค่าวิกฤตจะมีอัตราการเคลือบของชิลิกอนบางส่วนซึ่งไม่ถูกทำปฏิกิริยาเป็นในไตรค์และพร้อมจะฟอร์มตัวเป็นชิลิกอนได้ออกไซด์เมื่อฟิล์มถูกเปิดสัมผัสกับอากาศทันที ปริมาณของชิลิกอนได้ออกไซด์ที่สูงกว่า 2 เท่าของปริมาณชิลิกอนจะทำให้เกิดความเสื่อมอัดบนเนื้อฟิล์มและเกิดการลอกตัวออกจากผิวกระจากฟิล์มชิลิกอนในไตรค์ที่ดีจะมีความโปร่งใส และมีค่าการส่งผ่านสูงถึง 80 % ตั้งแต่ส่งผ่านความยาวคลื่น 400 นาโนเมตร ถึงช่วงอินฟราเรด และมีค่าดัชนีหักเหที่ความยาวคลื่น (λ) 550 นาโนเมตร เท่ากับ 2.033 สภาวะการเคลือบที่ให้ค่าน้ำดูลัสซีคที่สูงและความแข็งสูงสุดมีค่า 200 GPa และ 12.4 GPa ตามลำดับ โดยผลที่ได้นี้เกิดที่สภาวะการเคลือบกำลังไฟฟ้า 160 วัตต์ ความกว้างพัลส์ไฟฟ้า 3696 นาโนเมตร ความถี่พัลส์ไฟฟ้า 100 กิโลเฮิร์ต และป้องก้าาร์กอนต่อไตรเจนอัตราส่วน 45 ต่อ 13 ถูกน้ำศักเซนติเมตรต่อวินาทีที่ความดันก้าวรวมขยะเคลือบ 7.18×10^{-3} มิลลิกรัม ฟิล์มชิลิกอนในไตรค์ที่ทดลองเคลือบลงบนกระจกมีค่าความหนา 4 ค่า 5.0 7.6 12.6 และ 25.2 นาโนเมตร สีของฟิล์มจะเป็นสีเหลืองเข้มขึ้นเมื่อความหนาของฟิล์มสูงขึ้น และเมื่อเคลือบฟิล์มชิลิกอนในไตรค์เป็นชั้นป้องกันบนฟิล์มที่มีค่าการปิดป้องรังสีต่ำที่มีเงินเป็นชั้นหลักทำให้ค่าการปิดป้องเพิ่มจาก 0.07 (ที่ ฟิล์มชิลิกอนในไตรค์หนา 5.0 นาโนเมตร) เป็น 0.095 (ที่ ฟิล์มชิลิกอนในไตรค์หนา 25.2 นาโนเมตร) การเคลือบฟิล์มป้องกันนี้ทำให้เกิดผลทางลบกับฟิล์มที่มีค่าการปิดป้องรังสีต่ำของ $TiO_2/Ag/Ti/TiO_2$ เนื่องจากช่วยเพิ่มค่าการส่งผ่านของรังสีอินฟราเรด จาก 20% เป็น 40% เมื่อเทียบกับขยะไม่มีชั้นป้องกัน และลดค่าดัชนีการสะท้อนความร้อนจาก 3.57 เหลือเพียงประมาณ 2.00 เท่านั้น ยิ่งกว่านั้นการศึกษานี้ได้ทดลองการเคลือบชั้นป้องกันชิลิกอนในไตรค์ที่ความหนา 12.6 นาโนเมตร ลงบนระบบฟิล์มซึ่งมีเงินเป็นชั้นหลักดังกล่าวเพื่อศึกษาการเกิดการรวมตัวเป็นก้อนของชั้นเงินเบริชเทียบกับเมื่อไม่มีชั้นป้องกันตลอดเวลา 1 ปี ผลการทดลองเป็นที่น่าพอใจมาก ฟิล์มที่มีชั้นป้องกันไม่เกิดการรวมตัวของชั้นเงินที่ชัดเจนเหมือนฟิล์มที่ไม่มีชั้นป้องกัน

ABSTRACT

181216

Humidity-induced degradation caused by physical agglomeration is a major problem in typical Ag-based low-emissivity films. Searching for hard protective layer to prevent the films from scratching and chemical reaction is necessary for long life operation. Silicon nitride(Si_3N_4) films deposited by D.C. pulse magnetron sputtering was chosen in this study. The study involved variable parameters of electrical power, pulse widths, pulse frequencies, film thickness, and gas flow rates of argon (Ar) and nitrogen (N_2). In order to obtain stoichiometric Si_3N_4 protective film the nitrogen flow rate should not less than critical value. If nitrogen flow rate is less than critical value there will be non-reacted silicon atoms in the film of Si_3N_4 and tend to form SiO_2 immediately when the film is exposed to atmosphere . SiO_2 has more than twice the volume of silicon and provided the peeled off result caused by compressive stress in the film. Good Si_3N_4 film is transparent with transmission of 80 percents in the region from $\lambda = 400 \text{ nm}$ to near infrared. Index of refraction $n (\lambda=550 \text{ nm}) = 2.033$. The best condition for highest Young modulus and hardness were 200 GPa and 12.4 GPa respectively. This was secured under deposition condition of 160 watts electrical power ,3696 ns pulse width ,100 kHz pulse frequency ,and gas flow rate of $\text{Ar:N}_2 = 45:13 \text{ sccm}$ at coating pressure of $7.18 \times 10^{-3} \text{ mbar}$. The thickness of Si_3N_4 had been tried at 5.0,7.6 ,12.6, and 25.2 nm on glass the color of films become more yellow like when the thickness increases. The emissivity of Ag-based films width protective layer change from 0.07 (at 5.0 nm thick) to 0.095 (at 25.2 nm thick).A negative result occurred when Si_3N_4 was deposited on top of $\text{TiO}_2/\text{Ag}/\text{Ti}/\text{TiO}_2$ films. It was the increasing of near infrared transmission from 20% to 40% and the decreasing of heat mirror index (HMI) from 3.57 to about 2.00. Moreover the best coating condition of Si_3N_4 of thickness 12.6 nm on silver-based film system was provided to observe silver agglomeration during one year long compare to the non protective film, the result was quite appreciated. We could not observe silver agglomeration under protective film compared to the unprotective one.